第六十七章 新品发布会

各个总理之间在开始的时候进行了深入了交谈，并且达成了一系列不可示人的交易，至于其中有些什么交易就不好说了。

而孙源玲的制作方法已经将每月的名额分了出去，但是能够将合理的制造方案拿上台面的就只有三家，分别是龙芯、AMD、麒麟这三家，而AMD的方案只不过是延续了硅基芯片的方案然后去除了功耗限制而已。

在龙芯需要产能之后麒麟也在后面紧紧地跟上随后也是将基于自研达芬奇架构的碳基芯片制造方案提交给了玲瑶科创，而孙源玲的分身看到这个之后直接将这个方案导入了机器中开始了制造，以其他厂家的产能作为预支还真是舒服。而在制成之后还是和以前的规矩一样，将100枚样片送到了华为的手上只要通过了测试那么就可以开始大规模的生产了。

而制造一百片手机所使用的SOC所使用的材料和时间都是很少的，而且因为手机所使用的SOC相比于电脑的CPU要小了很多，所以所对应的产量也可以在一定的程度上出现提高。

而玲瑶科创的效率也是十分的高，在华为的设计图提交之后的第二天就将SOC送到了华为的手上，而运送的方法则是专人专送，所以速度相当的快。

华为设计研发部——

“任总，玲瑶科创方面已经将样片生产出来了并且已经送到了，要不要开始进行测试？”

以为技术总管说到。

“这么快？难道他们的机器生产是不需要进行测试而是直接按照设计图来制造就完事了吗？唉，人家的技术咱也不明白既然已经到了就开始测试吧，在测试合格之后就可以向他们提出kirin1020的量产需求了。”

“好的，我立刻去安排。”

“嗯，及得做极限测试往直接报废的那个方向测试。”

“明白。”说罢那个主管便直接走出了房门来到了技术研究开发部。

“嘿，兄弟们过来测试芯片了，这次我们设计的是基于kirin 990 5G版基础上改造来的，直接套在MTAE 30 Pro的板子上开始测试，这次给出了测试芯片一共为20枚。测试的时候记得测试极限情况和极限性能，炸了没事还有更多的可以更换。”

“好。”众人一口同声的回答道。

“那好，这10枚作为备用的测试芯片，这10枚作为第一波测试芯片各个小组来领取你们的芯片，我要在两天之后拿到可用的数据。”

各个小组上前拿到了芯片之后便开始了各种测试，在测试的过程中这些工程师还真的是对这些芯片一点也不温柔，真就因为电压超得太过了直接炸了一片，其巨大的威力直接将测试平台炸坏了。

而孙源玲此时正在以一个普通天才的角度去研究着AR眼镜，虽然这样的孙源玲仍然是压着整个研究团队都抬不起头，知识量始终不是在一个量级上的。至于AR眼镜的进展也是相当的迅速。

时间过去的很快，两天很快就过去了而华为测试的人已经完成了芯片的测试了，虽然没有对芯片进行长时间的极限压力测试，但是这样的测试也是暂时用不到在手机上的。

“各位，测试已经完成了吗？那个作死的那位，没事吧？将正常的台式机CPU所使用的电压和电流加到手机芯片上你也是做得出来。”

“好了，相应的测试数据已经完成了总结了，不过整个测试的结果也是相当的令我们惊讶。”那位工程师显然对于自己团队的设计表示十分的满意。

“好了，不用急着现在惊讶，先将报告给我，在合格之后就可以开发布会了，最新的CPU终于可以摆脱外国的依赖了，就是有些可惜我们那些正在研发光刻机的兄弟了，这个碳基芯片似乎并不兼容光刻机。”

而听到了这个消息的众人很是惊讶，因为在他们的认知当中这个很有可能是基于目前国内可能的基于28nm的光刻机进行雕刻的，但是没有想到这个并不是基于光刻机的制造工艺和技术。

技术总管在拿到了各个的研究报告之后继续说道：

“各位，接下的研发方向就是基于14nm甚至于7nm、3nm制程的芯片了，不要怀疑我的猜测。

这个玲瑶科创的实力十分的恐怖，他们的芯片能够在这么短的时间之内完成生产的原因很有可能是：他们所使用的制造是将碳原子直接堆积成设计图所设计的样子。而且，他们很有可能是拥有自己设计出更加优秀的芯片架构的能力，而将芯片的设计交给其他的厂商很有可能是带动全球一起发展，也有可能是防止被垄断调查。”

“老大你怎么知道的啊？”

“上面透露的，别和别人说是我我跟你们说了这些，万一事情真的是这样的你们的工作肯定会更加的累。

行了，你们加油我去给任总报告一下这个芯片的情况，相信这个芯片可以带领我们走出封锁的困境。”

……

“任总，碳基芯片的测试已经基本完成了，在极限的条件下都可以稳定运行已经符合了预期可以开始量产了。”

“恩，测试报告我看看，你们在测试的时候测试台发生了爆炸没事吧？”任总一边看着手里的测试报告一边向这个总管询问着详细的事情。

“在一个测试的工程师在测试的时候将CPU的电压加到了4.55伏特，50安培的电流在通电没有多久这个SOC因为散热实在是跟不上于是直接炸了，其中的碳单质因为高温迅速的燃烧但是整个事情很快就得到了控制，并没有引起多大的损失。”

“嗯，知道了去通知玲瑶科创方面SOC的量产可以开始了，将其余的尾款通知财务给他们打过去，就沿用MATA 30 Pro 5G的主板作为载体适当的提高功耗外形方面由你们来决定，一个周之后我要看到一个还不错的外形设计。”

“明白。”

其实外形这东西华为也是有许多的设计方案的，只是没有将这些方案应用到实际的机型上而已，而这次因为要更新换代但是所使用的主板依然是kirin990所使用的主板，所以外形方面可以在上代的MATA 30Pro 5G上稍作改变就可以完成设计了，只是这个简单的设计为了满足用户的需求，设计师们还是掉了不少的头发，终于在3天后拿出了令人满意的方案。

于是在经过多方协商和调整之后终于在外形完成设计的第八天完成了第一部样机的小批量生产。

任总站在舞台上，嘴上漏出了会心的微笑。

“欢迎各位来到这次新品发布对，很抱歉这次没有提前一段时间通知大家导致时间有些紧迫，然而计划永远比不过事情的变化。所以这次新品发布会显得有些仓促，但是这次的产品可是一点也不仓促，我们拿出我们压箱底的技术，目的就是为了抵抗漂亮国的打压。

我们经过了十多年的努力终于可以做到在手机芯片的设计领域与高通、联发科、三星持平甚至是拥有领先高通半年的优势。

而就在我们的芯片呈现出领先优势并且设计出5nm工艺的cpu时，漂亮国一纸禁令下来我们的SOC面临着无芯可用的境界，为此我们紧急的向着台积电加急5nm订单，争取多屯一些货，这样可以多支撑一段时间以等到国内的技术赶上。

而就在我们认为需要吃库存以度过这个无芯可用的阶段时，另外一家并不起眼的科技公司站了出来他就是‘玲瑶科创’

这家公司在各个时候都是十分的低调，但是正因为其低调所以能够在没有任何人阻拦的情况下成功的研发出了基于28nm的碳基芯片制造工艺。

看着这种类型的芯片制程感觉有些落后，但实际情况却是我们可以将一个可以进行独立运算的运算单元放进一个28nm\*28nm\*28nm碳基中，综合下来与7nm制程相比用于计算的单元只是少了20%左右，而我们也是设计出来基于碳基芯片的架构，这种架构可以更好的发挥出碳基芯片的优秀，基于以上制造的SOC我们将其命名为kirin1020.而这颗SOC我们将会用于我们最新的一代旗舰机HUAWEI MATE 50系列中。

”

说完任总从台下拿出了一台手机。

“这台手机就是最新的HUAWEI mate 50，它搭载了最新的基于28nm制程的碳基芯片kirin1020，其中包含了逻辑计算核心、GPU图像计算核心、5G通信模块等核心的高度集成。

其CPU规格为8个物理核心16线程，核心采用的都是大核，没有小核最高可以达到全核心3.64GHZ的运算速度，当然这种程度的运算速度需要连接充电器并且要在良好的散热环境下才能够达到。

当手机的负载不大的时候会动态分配性能和功耗，以保证最大化的续航。而我们的GPU的频率更是达到了最高1.75GHZ的速度，并且支持第三代GPU turbo技术使得图形性能及其计算性能都得到了大幅度的提升。

但是这个提升并不是没有代价的，整个SOC在满载的时候功耗已经来到了65W，没错就是来到了65W的功耗，要维持最高新能不仅要在手机的背面加装额外的散热装置还要连接上罪行的95W快充并且手动切换到最高性能模式。在完成之后手机的性能就已经可以比拟几个月前主流的电脑配置了。因为现在主流的都是龙芯的碳基芯片了，相比之下我们的功耗要温柔很多。

配合我们自研的原初OS系统，加上穹苍的支持我们已经做到了将手机完全当做一个电脑主机的能力了，只要连接上我们附加的type-c拓展坞你甚至可以在mate 50上玩3A大作，只是画质并不是很好而已。”

整个发布会因为是在网络上同步直播的，并且有抽奖送的环节。虽然这个发布会在开始的时候并没有多少人，但是后面关注的人就慢慢的多了起来。